

2025 年 11 月 26 日

報道関係各位

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社

当社 NS-TEPreg が VAIO 株式会社の新ノートパソコン「VAIO SX14-R」に採用

～ 軽量化・高堅牢性・高デザイン性・高放熱性を実現 ～

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：右田彰雄）が開発した「NS-TEPreg[®]」（熱可塑性樹脂を用いたカーボン繊維複合材料）が、VAIO 株式会社の新ノートパソコン「VAIO[®] SX14-R」の筐体に採用されました。

新製品「SX14-R」の筐体は、当社「NS-TEPreg[®]」の加熱成形時に自由に賦形できる特長や他の熱可塑性プラスチック部品との熱融着接合できる特性を活かして、デザイン性を有するエッジ部形状の加工において、パーツ同士の接合境界が目立たない一体感ある外観が実現されています。

「NS-TEPreg[®]」は、成形後の表面平滑性に優れているため、新製品での塗装においては繊細なカラーリングや質感の表現が可能となり、製品の意匠性・外観価値を一層高めています。

また、当社グループ会社の日本グラファイトファイバー株式会社が保有するピッチ系高弾性炭素繊維「GRANOC[®]」を適用することで、軽量かつ高剛性といった物性の付与が実現でき、筐体の薄型化と同時に高い堅牢性が確保されています。さらに、熱伝導性の高いピッチ系炭素繊維により、装置全体の排熱効率を高めることができるため、電子部品が集積する製品の放熱設計にも貢献しています。

「NS-TEPreg[®]」は、独自開発の特殊フェノキシ樹脂が熱可塑の性質を有していることから、再利用がしやすく、マテリアルリサイクルも可能となるため、これからの環境配慮に貢献する新しい素材として注目を集めています。

当社は今後も、独自素材の開発とパートナー企業との連携を通じて、次世代製品の創出、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 総務部（広報）

TEL：03-3510-0301

E-mail：info@ml.nscm.nipponsteel.com

以 上